

**Technical Information**

**Adtra TL2120**

**技术参数**

**06. 2018**

**产品描述**

TL2120是单组分环氧树脂类填充材料。本产品可120℃快速固化；本产品具有低粘度,快速流动,可快速通过例如25微米的较小间隙,良好的可维修性。具有良好的粘接强度和电性能。

**应用**

PCB 或 FPCB 上 BGA、 $\mu$ BGA、CSP 芯片的可返修底部填充作业。

**未固化材料特性**

	典型值
外观	黑色液体
化学类型	环氧树脂
粘度 (mpa.s) @25℃	2000±1000
使用期 (天) @ 25℃	14
密度 (g/cm <sup>3</sup> )@25℃	1.13

**推荐固化条件**

在120℃固化6min或110℃固化10min

固化速度的快慢,取决于加热设备的加热效率和被加热PCB板的厚度以及芯片大小。要根据加热设备和被粘接物体适当的调节固化温度和固化时间。

**固化后材料特性**

(试样在120℃固化6min)

物理特征	典型值
硬度 (邵氏D) (GB/T 2411-1980)	75
玻璃化温度点 (℃) (ASMT E1545)	65
断裂伸长率 (%) (GB 1040-1992)	3
热膨胀系数 (GB/T 1036-1989)	
$\alpha_1$ (ppm/℃)	55
$\alpha_2$ (ppm/℃)	180
导热系数 (W/m℃)	0.2
吸水率 (%) (24h@25℃)	0.16

## 电气特性

体积电阻率 (Ω·cm)	$4.0 \times 10^{16}$
表面电阻率 (Ω)	$1.5 \times 10^{15}$
介电常数/介电损耗	
1KHz	3.2/0.016
100KHz	3.0/0.02
介电强度 (Kv/mm)	16.5

---

## 使用说明

恢复到室温才可以使用，在恢复到室温以前请不要打开包装。  
可在室温下直接填充。  
建议采用“一”字形或“L”形涂胶，在用“一”字涂胶时涂胶长度为芯片边长的80%。涂胶速度为 未用完的胶，须密封后再放入2-8℃冰箱贮存。每个包装的产品可回温使用2-3次，不建议多次回温使用。

---

## 注意事项

请远离儿童存放。  
本品建议在通风良好的场所内使用。  
若不慎沾到皮肤上，请马上用肥皂水清洗。  
若不慎沾到眼睛上，请先用大量的水清洗，然后就医。  
详细内容请参阅本品的 MSDS。

---

## 贮存条件/包装规格

在2-8℃洁净、干燥处贮存。  
贮存期：六个月。

包装：    30m/支  
            50m/支

## 声明：

本文的数据均为实验室条件下获得，由于使用条件的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和实验。Adtra 公司不担保销售Adtra 产品和特定工况下使用Adtra 产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。

用户在使用中遇到问题，可以和Adtra 公司当地业务人员联系，我们将为您提供一切帮助。